산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	**보도자료**	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 12월 9일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 12.9.(목) 12시(정오) 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 12. 8.(수)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박찬기 과장(044-203-4270)	담 당 자	김건혁 사무관(044-203-4274)

한국과 미국, 반도체 산업 협력을 위해 손 맞잡다

- 제1차 한미 반도체 파트너십 대화 개최 -
- 미래 공급망 리스크 검토 및 기술개발, 인력, 투자 협력방안 모색 -

□ **산업통상자원부**(장관 문승욱, 이하 '산업부')는 **'21.12.9일(목) 8시**(미국 시각 12.8(수) 18시) **제1차 「한미 반도체 파트너십 대화」**(이하 반도체 대화)**를 개최**하였다.

○ 코로나19 상황을 고려해 화상으로 개최된 이번 회의에는 한국측에서 산업부, 반도체산업협회, 산업기술진흥원, 산업기술평가관리원, 무역투자진흥공사(KOTRA)가 참석했고, 미국측에서는 상무부, 美 반도체산업협회(SIA), 국가기술표준원(NIST), SRC(반도체 민관연구 컨소시엄), Select USA, 국제협회인 반도체 장비재료협회(SEMI)가 참석하였다.

< 행 사 개 요 >

■ **(개요)** 2021.12.9(목) 08:00~10:00 / 화상회의 (한국 장소 : 반도체산업협회)

■ **(참석)** (한국측) 산업부 소재융합산업정책관, 반도체산업협회, 산업기술평가관리원, 산업기술진흥원, 무역투자진흥공사 등
(미국측) 상무부 부차관보, 美 반도체산업협회, NIST, SRC, Select USA 등
(국제협회) 반도체장비재료협회(SEMI)
* SIA(Semiconductor Industry Association: 미국 반도체산업협회), NIST(National Institute of Standard and Technology: 미국 국가기술표준원), SRC(Semiconductor Research Corporation: 반도체 민관연구 컨소시엄), SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International, 반도체장비재료협회)

■ **(내용)** 반도체 협력대화 총괄 회의, 공급망 워킹그룹 회의, 산업협력 워킹그룹 회의 등

□ 반도체 대화는 금년 5월 개최한 **한미 정상회담의 구체적인 성과 창출**을 위해 지난 **11월 산업부와 미 상무부 간 장관 회담**에서 최종 결정되었다.

○ 이번 회의에서 **양국은 글로벌 반도체 공급망 회복을 위한 의지와 기대**를 표명하였으며, **우호적인 분위기**에서 진행되었다.

□ 한미 반도체 협력을 위한 분야별 세부 논의를 진행하는 **공급망 워킹그룹, 산업협력 워킹그룹** 논의도 진행되었다.

○ **공급망 워킹그룹 논의**에서는 **양국 반도체 공급망 현황**과 **미래 공급망 강화 방향**에 대해 설명하였으며,

○ 산업협력 워킹그룹에서는 양국의 분야별 대표 기관이 **기술개발, 인력, 투자 분야의 협력 방안**을 논의했다.

○ 특히, 한국측에서는 **전기차, 신재생에너지** 등 신산업 분야의 수요 증가가 예상되는 **전력반도체, 탄소저감 공정·기술 개발** 등을 **잠재적인 기술개발 협력 프로젝트**로 제안하였다.

□ 이번 회의를 시작으로 **매년 가을 韓美 양국이 번갈아 반도체 협력 대화**를 **개최***하기로 하였다.

* 매년 10월~11월 개최하는 GAMS(Governments/Authorities Meeting on Semiconductor, 韓, 中, 美, 日, EU, 대만 참여하는 정부 간 반도체 관련 회의) 이전, 또는 이후에 반도체 대화 개최

○ 참여한 기관들은 오늘 회의부터 논의를 본격적으로 시작해 **내년 1분기 차기 워킹그룹 회의를 개최**하고,

○ **'22년 가을 한국에서 개최**하는 **제2차 반도체 대화**에서 워킹그룹의 1년간 **논의 결과와 협력 프로젝트 추진 현황**을 보고할 계획이다.

□ 앞으로, 공급망 워킹그룹에서는 **반도체 산업의 미래 수요와 공급을 분석**해 **공급망 불안 요인을 사전에 검토**하고 이와 관련한 **공급망 강화 방안**을 논의하기로 하였다.

○ 산업협력 워킹그룹에서는 **민관 연구계, 산업계가 참여해 자국의 반도체 기술개발 로드맵을 공유**하고 **공동 연구**가 필요한 분야의 **프로젝트를 발굴하여 협력**하면서, 관련한 인력 교류 협력방안도 논의할 계획이다.

○ 이를 위해, **반도체 산업 최초 산학 연구컨소시움인 미국의 SRC**와 **한국**의 **산업기술 R&D를 기획·총괄**하는 **산업기술평가관리원은 양국 기술·인력 협력을 지원**하기 위한 **MOU를 체결**하였다.

□ 아울러, 반도체 분야 세계 최대 전시회인 **세미콘**('22.2 서울, '22.7 샌프란시스코)에 **KOTRA와 Select USA가 참여**해 양국 공급망 강화를 위한 **韓-美 기업의 투자유치를 지원**하는 방안도 논의하였다.

□ 한미 양국은 한미 반도체 대화가 양국의 신뢰를 바탕으로 반도체 산업 경쟁력과 공급망을 강화하는 **"Trust Value Chain" 구축의 계기**가 될 것이라는 데 공감하였다.

【붙임】 한미 반도체 파트너십 대화 1차 회의 개최 계획

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 김건혁 사무관(☎ 044-203-4274)에게 연락주시기 바랍니다.

붙 임 **「韓·美 반도체 파트너십 대화」 1차 회의 개최 계획**

1. 파트너십 대화 구성 및 운영 (안)

○ **(명칭) 한미 반도체 파트너십 대화** (Semiconductor Partnership Dialogue(SPD))

○ **(주기) 매년 한국과 미국**에서 번갈아 개최

○ **(구성·참석) 공급망 워킹그룹, 산업협력 워킹그룹** 등 2개 작업반 구성

– **(韓)** 산업부, 반도체산업협회, 산업기술평가관리원, 산업기술진흥원, 무역투자진흥공사 등

– **(美)** 상무부, 미국 반도체산업협회(SIA), 국가기술표준원(NIST), 셀렉트 USA(Select USA)

* SIA(Semiconductor Industry Association: 미국 반도체산업협회),
NIST(National Institute of Standard and Technology: 미국 국가기술표준원),
SRC(Semiconductor Research Corporation: 반도체 민관연구 컨소시엄),

– **(국제협회)** 국제 반도체 장비재료협회(SEMI, Semiconductor Equipment and Materials International)

2. 1차 회의 개최 개요

○ **(일시/장소) 12.9(목) 8:00~10:00 화상회의** (美 12.8 18:00~20:00)

○ **(참석자)** 韓-美 정부, 산업계, 연구계, 공공기관, 국제협회 등

* (한국측) 산업부 소재융합산업정책관, 반도체산업협회, 산업기술평가관리원, 산업기술진흥원, KOTRA 등

* (미국측) 상무부 부차관보, 美 반도체산업협회, NIST, SRC, Select USA 등

* (국제협회) 반도체장비재료협회(SEMI)

○ **(주요 논의내용)** 반도체 파트너십 대화 운영계획, 공급망 워킹그룹 및 산업협력 워킹그룹 진행 방향 논의, 기술개발, 인력교류, 투자 등 분야별 협력방안 제안 등